

募集内容

1	板金加工	板金加工・溶接・塗装	半導体製造装置の筐体から工作機械 形状:機械加工品の架台など 素材:鉄など サイズ:最大1,000mm×2,500mm×2,500mm程度	<ul style="list-style-type: none"> 加工機(ターレットパンチプレス、ブレーキ) 溶接機(TIG, MIG, YAG, ファイバーレーザー) 塗装設備 半導体装置メーカーへの納入実績があると望ましい。
2	機械加工	機械加工	形状:図面による 素材:主にアルミ サイズ:ご参考 (□100mm~500mm程度) (Φ100mm~500mm程度)	<ul style="list-style-type: none"> 加工機(フライス・旋盤) ※検査設備が充実しているとなお良い 加工から表面処理までを自社もしくは協力外注にて一貫生産できる企業を希望 半導体装置メーカーへの納入実績があると望ましい。 生産拠点:日本・タイ(もしくは周辺国、アセアン地域)2拠点をもちサプライヤーが望ましい
3	アルミ鋳物の加工品	機械加工	形状:図面による 素材:主にアルミ サイズ:ご参考 (Φ1,000mm×L500mm程度)	<ul style="list-style-type: none"> 鋳造設備(造型機他) 加工機(フライス・旋盤) 表面表面処理設備
4	ハーネス加工	ハーネス加工	図面指示による	<ul style="list-style-type: none"> ラベルプリンター(キャノ製又はICTK製) 半導体装置メーカーへの納入実績があると望ましい。 生産拠点:日本・タイ(もしくは周辺国、アセアン地域)2拠点をもちサプライヤーが望ましい
5	樹脂加工	樹脂加工	形状:図面による 素材:ナイロン、硬質塩ビ、アクリルほか サイズ:ご参考 (□100mm程度) (Φ10mm×100mm程度)	<ul style="list-style-type: none"> 半導体装置メーカーへの納入実績があると望ましい。 生産拠点:日本・タイ(もしくは周辺国、アセアン地域)2拠点をもちサプライヤーが望ましい